

Presseinformation

Neues 3D Inline-Röntgensystem iX7059 für große Baugruppen bis 1600 mm von Viscom

Hannover, 18. März 2021 – Große Flachbaugruppen hochpräzise und schnell inline in 3D zu prüfen, ist Kernaufgabe des neuen kompakten 3D-AXI-Systems von Viscom. Die besondere Schärfe der Schichtbilder zeigt die extrem hohe Prüfgenauigkeit, die speziell für dicht bestückte und sehr komplexe Boards erforderlich ist, um versteckte Lötstellen und kritische Voids in Flächenlötungen aufzuspüren. Modernste 3D-Röntgentechnologie der Evolution 5 mit integrierter planarer CT im Zusammenspiel mit einem neuen Handlingskonzept sorgen für beste Prüfergebnisse bei höchsten Taktzeitanforderungen.

Das neue System **iX7059 PCB Inspection XL** von Viscom ist prädestiniert für den Einsatz in Fertigungslinien, die Flachbaugruppen, LEDs und auch Leistungshalbleiter für E-Mobilität oder Hochspannungs-/Gleichspannungs-Übertragungstechnik produzieren und eine hundertprozentige Qualitätskontrolle benötigen. Für die angestrebte Nullfehlerstrategie ist eine lückenlose, hochpräzise Fehlerdetektion bei höchstem Durchsatz durch die neue 3D-Inline-Röntgeninspektion der iX7059-Generation gewährleistet. Das Herzstück der iX7059 PCB Inspection XL stellt eine leistungsstarke Mikrofokus-Röntgenröhre dar, **die zerstörungsfrei und mit hoher Durchstrahlung** dicke, sehr dichte und zweiseitig bestückte Baugruppen umfassend inline prüft, sodass auch verdeckte Lötstellen bei starken Abschattungen sicher detektiert werden. Die geschlossene 130 kV-Röhre, optional kann auch eine 160 kV-Röhre eingesetzt werden, ist wartungsfrei. Der Inspektionsumfang deckt eine **intelligente Voidvermessung** hinsichtlich Anzahl, Größe und anteiliger Fläche sowie eine vollständige Lötstelleninspektion von bedrahteten Bauteilen und auch bei Multi-Layer-Boards ab, was sehr relevant für Hybrid Power Module, Chip-Layer und Substrate-Layer ist.

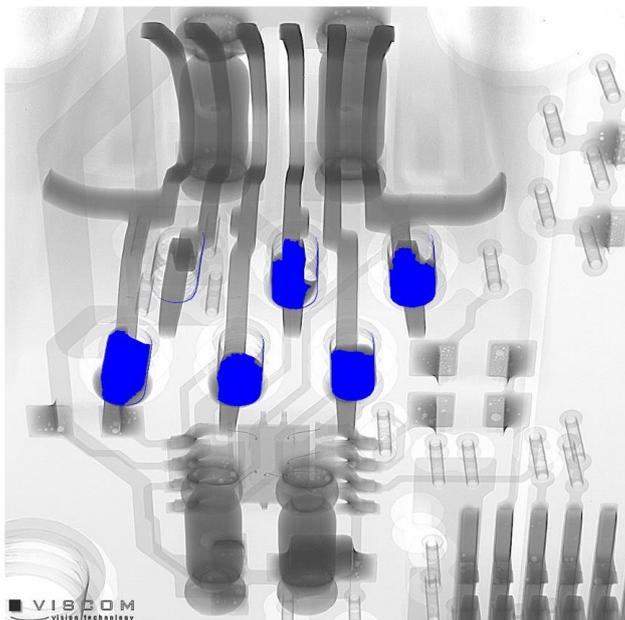
Das flexible Röntgensystem ermöglicht die Realisierung passgenauer Prüfstrategien in 2D, 2.5D und 3D mit einer Auflösung von 8,5 µm bis 25 µm. Für die hochgenaue und sehr schnelle 3D-Röntgeninspektion kommt **das neue Bildaufnahme-konzept Evolution 5** mit der neuen Flat Panel Detektor-Generation T3 zum Einsatz. Die 3D-Bildaufnahmen – bis zu 120 Bilder in rund 5 Sekunden für einen Field of View – erfolgen aus verschiedensten Ansichten und mit Schrägdurchstrahlung in der Bewegung, sodass die Inspektionszeit noch weiter optimiert werden konnte. In Kombination mit der leistungsstarken planaren Computertomografie werden alle signifikanten Merkmale in Schichtbildern mit großer Detailgenauigkeit sichtbar. Das vereinfacht die Verifikation, reduziert Falschalarme, spart zeitaufwändige Nacharbeit und vermeidet kostspieligen Produktausschuss.

Das Inline-System iX7059 PCB Inspection XL **mit neuem Handlingskonzept** transportiert und detektiert Leiterplatten – auch auf Werkstückträgern – bis zu 15 kg und einer Größe von 660 x 1000 mm, optional bis 1600 mm Länge dank der Extended Longboard Option. Das kompakte moderne Systemdesign mit den Abmessungen 1493 mm x 1654 mm x 2207 mm (B x H x T) erlaubt eine Inline- oder Insel-Aufstellung mit kleinstem Footprint.

Zu den weiteren Highlights zählen eine automatische Grauwertkalibration, Barcode-Scanner (optional), eine M2M-Vernetzung via Viscom Quality Uplink sowie ein auf die Kundenanforderungen zugeschnittenes MES-Interface für eine vollständige Traceability. Die komfortable Systembedienung über den modernen Touchscreen-Monitor und die einfache, schnelle Erstellung von Prüfprogrammen via der Bediensoftware vVision oder EasyPro runden das Systemkonzept ab.



01_ix7059 PCB Inspection XL: Neue 3D-Inline-Röntgeninspektion mit CT für die High-End-Elektronikfertigung



02_Neues Viscom 3D-AXI-System für die hochpräzise Void-Vermessung von Flächenlötungen sowie für die THT-Lötstellenkontrolle

Über Viscom

Die 1984 gegründete Viscom AG gehört im Bereich der Baugruppeninspektion in der Elektronikfertigung zu den führenden Anbietern weltweit. Das Unternehmen, mit Hauptsitz und Fertigungsstandort in Hannover, entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige Inspektionssysteme aus den Bereichen AOI, SPI, AXI, MXI, Bondinspektion sowie CCI für die Schutzlackinspektion. In puncto Genauigkeit und Schnelligkeit setzen die Systeme aus Hannover Maßstäbe. Das Produktspektrum umfasst die komplette Bandbreite der optischen Inspektion und Röntgenprüfung für kleine- und mittelständische Unternehmen sowie die Großserienfertigung. Die Systeme von Viscom werden bei der 100%igen automatischen Inspektion von elektronischen Baugruppen eingesetzt, wie zum Beispiel in der Produktion von Automobilelektronik, der Luft- und Raumfahrttechnik oder bei der Fertigung von Telekommunikationselektronik.

Im Fokus der Produktentwicklung stehen zudem kundenspezifische Systementwicklungen sowie die Vernetzung mit anderen Fertigungsprozessen für Smart Factory-Anwendungen. Um dies zu erreichen, investiert die Viscom AG verstärkt in die eigene Software- und Hardware-Entwicklung, die immer wieder neue Standards in der Inspektionstechnologie definiert.

Der internationale Vertrieb erfolgt über ein breites Netz aus eigenen Niederlassungen, Applikationszentren, Servicestützpunkten und Repräsentanten. Ein Serviceteam aus eigenen Technikern und Anwendungsspezialisten nimmt die Viscom-Anlagen weltweit in Betrieb und bietet Instandhaltung, Umbau und Modernisierung aus einer Hand. Darüber hinaus werden systemspezifische Schulungen für Bediener, Programmierer und das Wartungspersonal der Kunden angeboten. Dabei stellen erfahrene Ingenieure und Techniker aus Applikation und Service ihr Expertenwissen den Teilnehmern zur Verfügung.

Seit 2006 ist die Viscom AG an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN: DE0007846867) notiert.